

# 中国IC（半导体）行业发展回顾与市场前景预测报告（2019-2025年）

中国市场报告网

360baogao.com

## 报告介绍

报告名称：中国IC（半导体）行业发展回顾与市场前景预测报告（2019-2025年）

报告编号：2357799

报告价格：纸质版：8500元 电子版：8800元 纸质+电子版：9000元

优惠价格：7800元

咨询电话：400 612 8668、010-66181099、010-66182099 传真：010-66183099

咨询邮箱：[kf@360baogao.com](mailto:kf@360baogao.com)

在线阅读：<http://www.360Baogao.com/9/79/ICBanDaoTiHangYeXianZhuangYuFaZh.html>

温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本报告，请向客服咨询。

报告目录：

中国市场报告网发布的中国IC（半导体）行业发展回顾与市场前景预测报告（2019-2025年）认为，半导体（semiconductor），指常温下导电性能介于导体（conductor）与绝缘体（insulator）之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品，如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，而硅更是各种半导体材料中，在商业应用上最具有影响力的一种。

《中国IC（半导体）行业发展回顾与市场前景预测报告（2019-2025年）》在多年IC（半导体）行业研究结论的基础上，结合中国IC（半导体）行业市场的发展现状，通过资深研究团队对IC（半导体）市场各类资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库，对IC（半导体）行业进行了全面、细致的调查研究。

中国市场报告网发布的中国IC（半导体）行业发展回顾与市场前景预测报告（2019-2025年）可以帮助投资者准确把握IC（半导体）行业的市场现状，为投资者进行投资作出IC（半导体）行业前景预判，挖掘IC（半导体）行业投资价值，同时提出IC（半导体）行业投资策略、营销策略等方面的建议。

### 第一章 2014-2018年中国半导体材料产业运行环境分析

#### 第一节 2014-2018年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、城乡居民家庭人均可支配收入
- 三、恩格尔系数
- 四、中国城镇化率
- 五、存贷款利率变化

zhōngguó IC(bàndǎotǐ) hángyè fāzhǎnhuígù yǔ shìchǎng qíanjǐng

yù cè bào gào (2019-2025 nián)

六、财政收支状况

第二节 2014-2018年中国半导体材料产业政策环境分析

- 一、《电子信息产业调整和振兴规划》
- 二、新政策对半导体材料业有积极作用
- 三、进出口政策分析

第三节 2014-2018年中国半导体材料产业社会环境分析

**第二章 2014-2018年半导体材料发展基本概述**

第一节 主要半导体材料概况

- 一、半导体材料简述
- 二、半导体材料的种类
- 三、半导体材料的制备

第二节 其他半导体材料的概况

- 一、非晶半导体材料概况
- 二、GaN材料的特性与应用
- 三、可印式氧化物半导体材料技术发展

**第三章 2014-2018年世界半导体材料产业运行形势综述**

第一节 2014-2018年全球总体市场发展分析

- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、亚太地区的半导体出货量受金融危机影响较小
- 四、模拟IC遭受重挫，无线下滑幅度最小

第二节 2014-2018年主要国家或地区半导体材料行业发展新动态分析

- 一、比利时半导体材料行业调研
- 二、德国半导体材料行业调研
- 三、日本半导体材料行业调研
- 四、韩国半导体材料行业调研
- 五、中国台湾半导体材料行业调研

**第四章 2014-2018年中国半导体材料行业运行动态分析**

第一节 2014-2018年中国半导体材料行业发展概述

- 一、全球代工将形成两强的新格局
- 二、应加强与中国本地制造商合作
- 三、电子材料业对半导体材料行业的影响

第二节 2014-2018年半导体材料行业企业动态

- 一、元器件企业增势强劲

## 二、应用材料企业进军封装

### 第三节 2014-2018年中国半导体材料发展存在问题分析

## 第五章 2014-2018年中国半导体材料行业技术分析

### 第一节 2014-2018年半导体材料行业技术现状分析

- 一、硅太阳能技术占主导
- 二、产业呼唤政策扩大内需

### 第二节 2014-2018年半导体材料行业技术动态分析

- 一、功率半导体技术动态
- 二、闪光驱动器技术动态
- 三、封装技术动态
- 四、太阳光电系统技术动态

### 第三节 2019-2025年半导体材料行业技术前景分析

## 第六章 2014-2018年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

### 第一节 2014-2018年中国第三代半导体材料相关介绍

- 一、第三代半导体材料的发展历程
- 二、当前半导体材料的研究热点和趋势
- 三、宽禁带半导体材料

### 第二节 2014-2018年中国氮化镓的发展概况

- 一、氮化镓半导体材料市场的发展状况
- 二、氮化镓照亮半导体照明产业
- 三、GaN蓝光产业的重要影响

### 第三节 2014-2018年中国氮化镓的研发和应用状况

- 一、中科院研制成功氮化镓基激光器
- 二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
- 三、非极性氮化镓材料的研究有进展
- 四、氮化镓的应用范围

## 第七章 2014-2018年中国其他半导体材料运行局势分析

### 第一节 砷化镓

- 一、砷化镓单晶材料国际发展概况
- 二、砷化镓的特性
- 三、砷化镓研究状况
- 四、宽禁带氮化镓材料

### 第二节 碳化硅

- 一、半导体硅材料介绍
- 二、多晶硅

三、单晶硅和外延片

四、高温碳化硅

## 第八章 2014-2018年中国半导体分立器件制造业主要指标监测分析

### 第一节 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业数据监测回顾

一、竞争企业数量

二、亏损面情况

三、市场销售额增长

四、利润总额增长

五、投资资产增长性

六、行业从业人数调查分析

### 第二节 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业投资价值测算

一、销售利润率

二、销售毛利率

三、资产利润率

四、未来5年半导体分立器件制造盈利能力预测

### 第三节 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业产销率调查 订' 购热' 线' 4' 00' - 6' 12' -' 8' 6' 6' 8

一、工业总产值

二、工业销售产值

三、产销率调查

## 第九章 2014-2018年中国半导体市场供需分析

在线阅读: <http://www.360Baogao.com/9/79/ICBanDaoTiHangYeXianZhuangYuFaZh.html>

### 第一节 LED产业发展

一、国外LED产业发展情况分析

二、国内LED产业发展情况分析

三、LED产业所面临的问题分析

四、2019-2025年LDE产业发展趋势及前景分析

### 第二节 集成电路

一、中国集成电路销售情况分析

二、集成电路及微电子组件（8542）进出口数据分析

三、集成电路产量统计分析

### 第三节 电子元器件

一、电子元器件的发展特点分析

二、电子元件产量分析

三、电子元器件的趋势分析

#### 第四节 半导体分立器件

- 一、半导体分立器件市场发展特点分析
- 二、半导体分立器件产量分析
- 三、半导体分立器件发展趋势分析

### 第十章 2014-2018年中国半导体材料行业市场竞争格局分析

#### 第一节 2014-2018年欧洲半导体材料行业竞争分析

#### 第二节 2014-2018年我国半导体材料市场竞争分析

- 一、半导体照明应用市场突破分析
- 二、单芯片市场竞争分析
- 三、太阳能光伏市场竞争分析

#### 第三节 2014-2018年我国半导体材料企业竞争分析

- 一、国内硅材料企业竞争分析
- 二、政企联动竞争分析

### 第十一章 2014-2018年中国半导体材料主要生产商竞争性财务数据分析

#### 第一节 有研半导体材料股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

#### 第二节 天津中环半导体股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

#### 第三节 宁波康强电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

#### 第四节 南京华东电子信息科技股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析

中國IC（半導體）行業發展回顧與市場前景預測報告（2019-2025年）

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节 峨眉半导体材料厂

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第六节 洛阳中硅高科有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节 北京国晶辉红外光学科技有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节 北京中科镓英半导体有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第九节 上海九晶电子材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节 东莞钛升半导体材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十一节 河南新乡华丹电子有限责任公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

## 第十二章 2019-2025年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节 2019-2025年中国半导体材料行业市场趋势

一、2019-2025年国产设备市场调研

二、市场低迷创新机遇分析

三、半导体材料产业整合

第二节 2019-2025年中国半导体行业市场发展预测分析

一、全球光通信市场发展预测分析

二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

第三节 2019-2025年中国半导体市场销售额预测分析

第四节 济研,咨,询,2019-2025年中国半导体产业预测分析

一、半导体电子设备产业发展预测分析

二、GPS芯片产量预测分析

三、高性能半导体模拟器件的发展预测

## 第十三章 2019-2025年中国半导体材料行业投资

图表 32 GAAS单晶生产方法比较

图表 33 世界GAAS单晶主要生产厂家的

图表 34 SIC器件的研究概表

图表 35 现代微电子工业对硅片关键参数的要求

图表 36 多晶硅质量指标

图表 37 2014-2018年中国半导体分立器件制造企业数量增长趋势图

图表 38 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业亏损企业数量增长趋势图

图表 39 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业亏损额增长情况

图表 40 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业主营业务收入增长趋势图

图表 41 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业利润总额增长趋势图

图表 42 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业资产增长趋势图

图表 43 2014-2018年金融危机影响下全球著名企业裁员名录

图表 44 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业从业人数增长趋势图

图表 45 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业销售利润率走势图

图表 46 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业销售毛利率走势图

图表 47 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业总资产利润率指标统计表

图表 48 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业总资产利润率走势图

图表 50 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业销售毛利率走势图

图表 51 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业销售利润率走势图

图表 52 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业总资产利润率走势图



图表 53 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业工业总产值情况

图表 54 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业工业销售产值走势

图表 55 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业产销率走势图

图表 56 2014-2018年中国集成电路市场销售额规模及增长图

图表 57 2014-2018年中国集成电路及微电子组件进出口统计表

图表 58 2014-2018年中国各省市集成电路产量统计（万块）

图表 59 2014-2018年中国各省市电子元件产量统计表（万只）

图表 60 2014-2018年中国各省市半导体分立器件产量统计表（万只）

中国IC（半导体）産業開発レビューと市場予測レポート（2019-2025）

图表 61 2014-2018年有研半导体材料股份有限公司主要财务指标表

图表 62 2014-2018年有研半导体材料股份有限公司成长性指标表

图表 63 2014-2018年有研半导体材料股份有限公司经营能力指标表

图表 64 2014-2018年有研半导体材料股份有限公司盈利能力指标表

图表 65 2014-2018年有研半导体材料股份有限公司偿债能力指标表

图表 66 2014-2018年天津中环半导体股份有限公司主要财务指标表

图表 67 2014-2018年天津中环半导体股份有限公司成长性指标表

China IC (Semiconductor) Industry Development Review and Market Forecast Report

(2019-2025)

图表 68 2014-2018年天津中环半导体股份有限公司经营能力指标表

图表 69 2014-2018年天津中环半导体股份有限公司盈利能力指标表

图表 70 2014-2018年天津中环半导体股份有限公司偿债能力指标表

图表 71 2014-2018年宁波康强电子股份有限公司主要财务指标表

图表 72 2014-2018年宁波康强电子股份有限公司成长性指标表

图表 73 2014-2018年宁波康强电子股份有限公司经营能力指标表

图表 74 2014-2018年宁波康强电子股份有限公司盈利能力指标表

图表 75 2014-2018年宁波康强电子股份有限公司偿债能力指标表

图表 76 2014-2018年南京华东电子信息科技股份有限公司主要财务指标表

图表 77 2014-2018年南京华东电子信息科技股份有限公司成长性指标表

图表 78 2014-2018年南京华东电子信息科技股份有限公司经营能力指标表

图表 79 2014-2018年南京华东电子信息科技股份有限公司盈利能力指标表

图表 80 2014-2018年南京华东电子信息科技股份有限公司偿债能力指标表

图表 81 2014-2018年峨眉半导体材料厂收入状况表

图表 82 2014-2018年峨眉半导体材料厂盈利指标表

图表 83 2014-2018年峨眉半导体材料厂盈利比率

图表 84 2014-2018年峨眉半导体材料厂资产指标表

图表 85 2014-2018年峨眉半导体材料厂负债指标表

- 图表 86 2014-2018年峨眉半导体材料厂成本费用构成表  
图表 87 2014-2018年洛阳中硅高科有限公司收入状况表  
图表 88 2014-2018年洛阳中硅高科有限公司盈利指标表  
图表 89 2014-2018年洛阳中硅高科有限公司盈利比率  
图表 90 2014-2018年洛阳中硅高科有限公司资产指标表  
图表 91 2014-2018年洛阳中硅高科有限公司负债指标表  
图表 92 2014-2018年洛阳中硅高科有限公司成本费用构成表  
图表 93 2014-2018年北京国晶辉红外光学科技有限公司收入状况表  
图表 94 2014-2018年北京国晶辉红外光学科技有限公司盈利指标表  
图表 95 2014-2018年北京国晶辉红外光学科技有限公司盈利比率  
图表 96 2014-2018年北京国晶辉红外光学科技有限公司资产指标表  
图表 97 2014-2018年北京国晶辉红外光学科技有限公司负债指标表  
图表 98 2014-2018年北京国晶辉红外光学科技有限公司成本费用构成表  
图表 99 2014-2018年北京中科镓英半导体有限公司收入状况表

#### 图表目录

- 图表 100 2014-2018年北京中科镓英半导体有限公司盈利指标表  
图表 101 2014-2018年北京中科镓英半导体有限公司盈利比率  
图表 102 2014-2018年北京中科镓英半导体有限公司资产指标表  
图表 103 2014-2018年北京中科镓英半导体有限公司负债指标表  
图表 104 2014-2018年北京中科镓英半导体有限公司成本费用构成表  
图表 105 2014-2018年上海九晶电子材料有限公司收入状况表  
图表 106 2014-2018年上海九晶电子材料有限公司盈利指标表  
图表 107 2014-2018年上海九晶电子材料有限公司盈利比率  
图表 108 2014-2018年上海九晶电子材料有限公司资产指标表  
图表 109 2014-2018年上海九晶电子材料有限公司负债指标表  
图表 110 2014-2018年上海九晶电子材料有限公司成本费用构成表  
图表 111 2014-2018年东莞钛升半导体材料有限公司收入状况表  
图表 112 2014-2018年东莞钛升半导体材料有限公司盈利指标表  
图表 113 2014-2018年东莞钛升半导体材料有限公司盈利比率  
图表 114 2014-2018年东莞钛升半导体材料有限公司资产指标表  
图表 115 2014-2018年东莞钛升半导体材料有限公司负债指标表  
图表 116 2014-2018年东莞钛升半导体材料有限公司成本费用构成表  
图表 117 2014-2018年河南新乡华丹电子有限责任公司收入状况表  
图表 118 2014-2018年河南新乡华丹电子有限责任公司盈利指标表  
图表 119 2014-2018年河南新乡华丹电子有限责任公司盈利比率  
图表 120 2014-2018年河南新乡华丹电子有限责任公司资产指标表

图表 121 2014-2018年河南新乡华丹电子有限责任公司负债指标表

图表 122 2014-2018年河南新乡华丹电子有限责任公司成本费用构成表

图表 123 2014-2018年中国半导体市场规模增长及预测情况

略……

订购《中国IC（半导体）行业发展回顾与市场前景预测报告（2019-2025年）》，报告编号：  
: 2357799,

请拨打: 400 612 8668、010-66181099、010-66182099

Email: [kf@360baogao.com](mailto:kf@360baogao.com), 传真: 010-66183099

在线阅读: <http://www.360Baogao.com/9/79/ICBanDaoTiHangYeXianZhuangYuFaZh.html>

## 相关报告

- ※ 中国IC（半导体）行业调查分析及市场前景预测报告（2018-2025年）
- ※ 2017年中国IC（半导体）市场现状调查与未来发展趋势报告
- ※ 2019-2025年中国IC（半导体）行业现状调研分析及发展趋势预测报告
- ※ 全球及中国紫外线固化系统市场现状调研与发展趋势分析报告（2019-2025年）
- ※ 2019-2025年中国高档数控机床市场深度调查分析及发展前景研究报告
- ※ 2019-2025年全球及中国燃气发动机市场调查及发展前景趋势分析报告
- ※ 中国线性直流电源行业现状调研及发展前景分析报告（2019-2025年）
- ※ 2019-2025年全球及中国层流柜行业发展现状调研与市场前景预测报告
- ※ 全球及中国电动缝纫机行业发展现状分析与市场前景预测报告（2019-2025年）
- ※ 2019-2025年中国MOS微器件市场现状调研分析及发展趋势报告
- ※ 2019-2025年全球及中国淬火机市场现状研究分析及发展前景预测报告
- ※ 全球及中国扣环行业现状调研及发展前景分析报告（2019-2025年）
- ※ 中国搬运机械行业发展回顾与发展趋势分析报告（2019-2025年）

在线阅读：<http://www.360Baogao.com/9/79/ICBanDaoTiHangYeXianZhuangYuFaZh.html>